

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年5月26日(2016.5.26)

【公表番号】特表2016-510951(P2016-510951A)

【公表日】平成28年4月11日(2016.4.11)

【年通号数】公開・登録公報2016-022

【出願番号】特願2015-561665(P2015-561665)

【国際特許分類】

H 05 K 1/02 (2006.01)

H 05 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 05 K 1/02 J

H 05 K 3/46 Q

【手続補正書】

【提出日】平成28年3月8日(2016.3.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

プリント回路基板アセンブリであって、

プリント回路基板を備え、前記プリント回路基板が、

複数の導電層と、ここで、前記複数の導電層における各導電層は、ギャップで隔てられた第1の部分および第2の部分を含み、前記導電層の第1の部分は第1の機能的エリアを形成し、前記導電層の第2の部分は第2の機能的エリアを形成し、少なくとも1つの導電層は接地面である、

複数の誘電体層と、ここで、前記複数の誘電体層の各誘電体層が、前記複数の導電層における導電層のペアの間に配置される、

R F周波数の信号が、前記接地面の導通を維持する複数のR Fキャパシタを通過することを可能にする、前記接地面に結合された前記複数のR Fキャパシタと

を備え、前記複数のR Fキャパシタは、前記ギャップをわたって前記第1の機能的エリアから前記第2の機能的エリアに伸びており、

交互になっている導電層におけるギャップは位置がずれている、

プリント回路基板アセンブリ。

【請求項2】

前記第1の部分は前記第2の部分よりも短い、請求項1に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項3】

前記第1の部分は、前記第2の部分から実質的に熱的に分離されている、請求項1に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項4】

前記複数の導電層の少なくともいくつかの第1の部分の長さは同じである、請求項1に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項5】

外部デバイスとのワイヤレス通信リンクを確立するように適応され、前記プリント回路基板の前記第2の機能的エリアに一体的に結合され、かつ前記プリント回路基板の前記第

2の機能的エリアと通信している、ワイヤレス通信モジュールをさらに備え、前記ワイヤレス通信モジュールは、データを送信および／または受信するためのアンテナアセンブリを有する、請求項1に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項6】

前記プリント回路基板に一体的に結合され、かつ前記プリント回路基板と通信しているデータ収集モジュールをさらに備える、請求項5に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項7】

前記データ収集モジュールは、血糖レベルを測定するように構成された血糖モジュールである、請求項6に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項8】

D C結合を引き起こす前記接地面に結合された金属トレースをさらに備える、請求項1に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項9】

前記ずれたギャップは、湾曲パターンを形成する、請求項1に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項10】

前記ずれたギャップは、一体的に結合された直線セグメントのパターンを形成する、請求項1に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項11】

プリント回路基板アセンブリを製造する方法であって、

プリント回路基板を提供することと、

前記プリント回路基板上に複数の導電層を提供することと、ここで、各導電層は、ギャップで隔てられた第1の部分および第2の部分を有し、交互になっている導電層におけるギャップは位置がずれており、前記導電層の第1の部分は第1の機能的エリアを形成し、前記導電層の第2の部分は第2の機能的エリアを形成し、少なくとも1つの導電層は接地面である、

前記プリント回路基板上に複数の誘電体層を提供することと、ここで、前記複数の誘電体層の各誘電体層は、前記複数の導電層における導電層のペアの間に配置される、

R F周波数の信号が、前記接地面の導通を維持する複数のR Fキャパシタを通過することを可能にする、前記接地面に結合された前記複数のR Fキャパシタを提供することと

を備え、前記複数のR Fキャパシタは、前記ギャップをわたって前記第1の機能的エリアから前記第2の機能的エリアに伸びる、方法。

【請求項12】

前記第1の部分は、前記第2の部分よりも短い、請求項11に記載の方法。

【請求項13】

前記第1の部分は、前記第2の部分から実質的に熱的に分離されている、請求項11に記載の方法。

【請求項14】

前記複数の導電層の少なくともいくつかの第1の部分の長さは同じである、請求項11に記載の方法。

【請求項15】

外部デバイスとのワイヤレス通信リンクを確立するように適応され、前記プリント回路基板の前記第2の機能的エリアに一体的に結合され、かつ前記プリント回路基板の前記第2の機能的エリアと通信している、ワイヤレス通信モジュールを提供することをさらに備え、前記ワイヤレス通信モジュールは、データを送信および／または受信するためのアンテナアセンブリを有する、請求項11に記載の方法。

【請求項16】

前記プリント回路基板に一体的に結合され、かつ前記プリント回路基板と通信しているデータ収集モジュールを提供することをさらに備える、請求項15に記載の方法。

【請求項17】

前記データ収集モジュールは、血糖レベルを測定するように構成された血糖モジュールである、請求項16に記載の方法。

【請求項18】

D C結合を引き起こす前記接地面に結合された金属トレースを提供することをさらに備える、請求項11に記載の方法。

【請求項19】

前記ずれたギャップは湾曲パターンを形成する、請求項11に記載の方法。

【請求項20】

前記ずれたギャップは一体的に結合された直線セグメントのパターンを形成する、請求項11に記載の方法。

【請求項21】

プリント回路基板アセンブリであって、

プリント回路基板を備え、前記プリント回路基板は、

複数の導電手段と、ここで、前記複数の導電手段における各導電手段は、ギャップで隔てられた第1の部分および第2の部分を含み、前記導電手段の第1の部分は第1の機能的エリアを形成し、前記導電手段の第2の部分は第2の機能的エリアを形成し、少なくとも1つの導電層は接地面である、

複数の誘電体手段と、ここで、前記複数の誘電体手段の各誘電体手段は、前記複数の導電手段における導電手段のペアの間に配置される、

R F周波数の信号が、前記接地面の導通を維持する複数のR Fキャパシタを通過することを可能にする、前記接地面に結合された前記複数のR Fキャパシタと

を備え、前記複数のR Fキャパシタは、前記ギャップをわたって前記第1の機能的エリアから前記第2の機能的エリアに伸びており、

交互になっている導電層におけるギャップは位置がずれている、

プリント回路基板アセンブリ。

【請求項22】

前記第1の部分は前記第2の部分よりも短い、請求項21に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項23】

前記第1の部分は、前記第2の部分から実質的に熱的に分離されている、請求項21に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項24】

前記複数の導電層の少なくともいくつかの第1の部分の長さは同じである、請求項21に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項25】

外部デバイスとのワイヤレス通信リンクを確立するように適応され、前記プリント回路基板に一体的に結合され、かつ前記プリント回路基板と通信している、ワイヤレス手段通信をさらに備える、請求項21に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項26】

前記プリント回路基板に一体的に結合され、かつ前記プリント回路基板と通信しているデータ収集手段をさらに備える、請求項25に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項27】

前記データ収集手段は、血糖レベルを測定するように構成された血糖モジュールである、請求項26に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項28】

アンテナアセンブリと、

前記接地面に結合された第1の機能的エリアおよび第2の機能的エリアと

をさらに備える、請求項21に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項29】

D C結合を引き起こす前記接地面に結合された金属トレースをさらに備える、請求項2

8に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項 3 0】

前記ずれたギャップは湾曲パターンを形成する、請求項 2 1 に記載のプリント回路基板アセンブリ。

【請求項 3 1】

前記ずれたギャップは一体的に結合された直線セグメントのパターンを形成する、請求項 2 1 に記載のプリント回路基板アセンブリ。